企画·制作=日本経済新聞社広告局

も着実に進展している。

が、そこではチップ表面 薄型化が進行している

にはパッケ ジュー

-ジ材料の耐

小型・低損失化を軸と

パワーデバイスでも微細

期待も高い。IGBTモ

ルのさらなる進化

例えば、LS・

上と同じ

電気自動車などでの

活躍しているが、SiC

電気自動車をはじめとす

バーターではシリコンの現在、電動車両のイン

GBTが

に向け、日産自動車では

酸化炭素排出量削減

化によるス

げるには、

などとは異

チップに加えパッケー にも技術が要求される。

たる。 冷却技術などが決め手と

れている。

そしてさらなる進化を遂

だけでなく裏面構造形成

高温化や放熱性の向上、

ど、多くの期待が寄せら

ターの小型化が欠かせ

合ダイオー

車ではSiCのヘテロ接

電池車にこのSiCダイ また世界に先駆けて燃料

テロ・ジャンクション・

をロー

イスへの期待は

の向上も可能とされるな

イッチング周波数の格段

用化と普及にはインバーる電動車両の開発を推進

使われている。日産自動 IGBTとダイオードが

%改善に成功して

ている。

インバーター効率の二〇

ダイオードの小型化と

方がどを達成。

めのキーデバイスとして T)は、省エネ実現のた

る分野で利用されてい

省エネのキーデバイスIGBT

る。

自動車・家電まであらゆ

では送配電・新幹線から

なるパワーデバイス独自

ンテリジェント・パワー

が広範な分野で用い

トランジスタ(MOSF

ア研究所主管研究員

星

正 勝

氏

オン抵抗○・八五mΩ平ップ角五ँ、耐圧九百ँ、、

日産自動車

総合研究所社会フロンティ

共同で新たに

に開発し、チ

ET)が関心を集めてい

酸化膜半導体電界効果型

要求される。現在ではイ レベルでも独自の技術が

ケイ素(SiC)、金属次世代技術として炭化

自動車用パワーデバイス

率化を実現してきたが、

デバイスは小型高効

の技術革新が求められ

・モジュー

ト型バイポー

富士電機デバイステクノロジー

開発統括部長

関

康和氏

3

スイッチング電源から配電システムにおけるパワーエレクトロニクス変換

その導入は産業用インバ 適用領域を広げている。

ターから始まり、現在

る。

もと、これからのエネルス」として長期的視野の

-革新技術を検証して

る。またエネルギーの効す創エネが注目されてい

ず、地域のEMSに広げに建物単位にとどまら

要性を増すと考えられる。 幹技術として、ますます重

た。

IGBTをはじめパ

-デバイス進化の結

バーターを発売。小型化換装置のマトリクスコン

果を得た。併せてノイズ

損失五〇%低減などの成

小型化

インバーターの損失

などで成果を挙げてい

組みを進めている。 や高温動作などにも取り により改良を重ねてき

BTを搭載したパワー

昨年にはRB-

の組み込み評価を行い、

GBTの登場により、パこのようにシリコンI

反映した「クー

元でエネルギーを生み出門では、省エネに加え手

ジメントが必要だ。さらする建物エネルギーマネ

まく使いこなすための基 技術は、エネルギーをう

発売、

IPMの導入など

る技術戦略検討の結果を

に目を向けると、民生部 現在のエネルギ

その出力変動を調整補償 導入した住宅などでは、

クスをはじめとする電力

に初めてIGBTを搭載

安川電機は一九八五年

はここ二十五年間で約五

Cパワーデバイスが注目

技術グループリーダ

大井

分の一に低減。低騒音化

安川電機ではオー

した汎用インバーターを

でも向上を遂げている。

る。

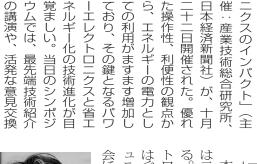
パワーエレクトロニ

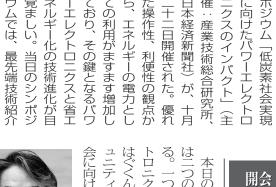
連の地球環境問題に対す

この特集は日経アドネットからもご覧になれます。

http://www.nikkei.co.jp/adnet 日本経済新聞社) た操作性、 に向けたパワ-|十二日開催され.

の講演や、活発な意見交換 が行われた。 ウムでは、最先端技術紹介 ら、エネルギーの電力とし ており、その鍵となるパワ ーエレクトロニクスと省エ この利用がますます増加し 化の技術進化が目 当日のシンポジ 利便性の観点か か、 た。 優れ











産業のこうことがワーエー もう一つは、パワーけられることである。 を宣言する機会と位置付

る。二酸化炭素(CO²) 進む中、さまざまな機器 排出削減のため、 の電力シフトが一層 エネル

グリーンーTのためのデータセンター

技術

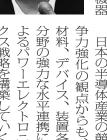
内航電気推進船の紹介

氏

争力強化の観点からも、 よるパワーエレクトロニ 分野の強力な水平連携に 日本の半導体産業の競 装置各



社会的責任 スが注目されている背景 には地球温暖化問題があ エレクトロニク



来賓 あいさつ

産業技術総合研究所シン

あいさつ

産業技術総合研究所

ション担当理事

伊 藤

うとともに、

商務情報政策局参事官 氏

最

端

技術

紹介に注目集まる

省の推進する「グリ の電力損失を大幅に削減 IT」政策の中核に位置 ロニクス技術を、経産

必要がある。

クス戦略を構築していく る。

設備を抱えるデー 膨大な情報機器や空調 主幹研究員 -は省エネが急務であ NTTファシリティ タセン 廣瀬 圭

ズは、その解決策とし 電源から負荷に至るま 交直の電力変換が多

ど損失が生じていた。 段に繰り返され、そのつ を低減、発熱を抑制する ない変換回数により損失 と同時に設備の信頼性向 方 直流供給では少

- ブ研究開発本部 ている。直流供給の研究給電効率の向上を想定し ず、IT(情報技術)の導 開発は海外でも進められ、 後は、高電圧直流供給も データセンター 当社試算では、約一五%の 入が進む住宅内にも検討 上やスリム化も実現する。 いる。今 みなら

重反転プロペラ(CRP)

リンユナイテッドでは二

アイ・エイチ・アイマ

の利点があるが、インバ

ターで電力変換するた

計画グループ技師 渡辺 学氏

料消費の二〇%低減を実

を解決。従来船に比べ燃より回収することでこれ

集めている。

ダクター社ではGaNパ

で使いやすいGaNデバ

省エネ化に役立つ、安全

することで、電気機器の ・トランジスタ)を開発

実現にも成功した。 のGaNトランジスタの 万点を超える超高耐圧 の目途も得た。さらに一

パナソニックセミコン

材料として、高い期待を

できるパワ

抵抗・高耐圧特性を実現

ート・インジェクションいる。独自のGIT(ゲ向けた研究開発を進めて

術を開発し、低コスト

a N結晶を成長させる技

リコン基板上へ良質なG

また、安価な六だシ

材料限界を超えた低オン

GaNは、シリコンの

ワーデバイスの実用化に

主幹技師 パナソニック

柳原

学 氏

セミコンダクター社

イスの実現に成功した。

GaNパワーデバイスの現状と課題

アイ・エイチ・アイマリンユナイテッド

基本設計部電気システ

のグリー

石油依存からの脱却に 門では石油依存度が極め て高い。ここでの過度の 現在、運輸・自動車部 ハイブリッド・電気 副研究部門長 伊藤 産業技術総合研究所 データセンター 情報技術研究部門 智

使う技術であるパワ と、電力を便利に有効に なる。こうした状況のも自動車などが有効手段と る。 情報技術研究部門では、 産業技術総合研究所の タセンター

求められている。この流

への一体的な取り組みが

電力の有効利用が鍵握る

環境保全・経済成長など

エネルギーの安全保障・ 状況が厳しさを増す中、

いう長期的視野に立ち、

エネルギーを取り巻く

れのもと、資源エネルギ

(CO゚) 排出の一三%削

ック時に比べ産業部門の欠かせない。オイルショ

など民生部門の省エネも 向ければ住宅やオフィス

るところが大きい

ネ型機器の普及に期待す ・空調など最先端の省エ

や高効率給湯

て直流供給による高効率

・高信頼化を提唱してい

既存の交流供給では、

エネルギー消費はほぼ横

減が可能との展望を示し

- 庁では十年・二十年と

資源エネルギー庁エネルギー政策企画室長 石崎

隆

氏

1

我が国のエネルギー政策

素社会実現のためのコア 技術として一段と重みを

存度が高い。このためグネルギー構成では電力依 伸びとなっている。 加えてこれら部門のエ ・構成では電力依

門では約二・五倍と高い レクトロニクスは、低炭

に比較し二〇年にはエネ

ギーの消費サイドに目を

のテーマとなる。エネル

通し」)を提示している。

そこでは、二〇〇五年

存を下げることが最重要

(「長期エネルギー

-需給見

社会を実現するには、依

今後、こうした低炭素

ばいなのに対し、民生部

然として高い化石燃料依

エネルギーの将来像

ることでその効果は高ま

低炭素社会実現に向けたパワーエレクトロニクスのインパクト

基調講演 2

パワーエレクトロニクスの重要性と課題

る。

東京大学生産技術研究所

特任教授

荻 本

和彦氏

率的使用を図るエネルギ

エネルギーとして注目さ

れている原子力や風力・

工学連携センターを設立所では今年、エネルギー

勢を強化している。

経済産業省は一

性が改めて認識された。

エレクトロニクスの重要 いるが、そこではパワ

増すことが予想される。

の再生可能エネルギー

産業用モー

タードライブ

太陽光発電を

は、使いやすい電気の形

(EMS)も今後重要性を

ーマネジメントシステム

に総合的に取り組む態

東京大学生産技術研究

した。併せて電気系や資

-を設立

創エネとEMSの重

要性増す

く電力に変換し需給に合

わせることが不可欠であ

で提供されるが、

効率よ

安川電機

ムリ

ダ

山田

健二氏

エレクトローラス

る。次世代のモータード

ライブシステムではSi

するなど、エネルギー問 源系でもセンター

カーボンフリ

れている限り、稼働状況ロセッサーでは電源を入 にかかわらず消費電力は に着目し電源を入れてい あまり変わらない。これ ン化の研究を進めてい 現在の情報機器のプ サービスを一サイトに集 ど稼働率が低いときには

る。例えば夜間や週末な 使い尽くす、が基本となは落とす、使うマシンは -タセンターの省エ ることが必要だ。 点からはグリー (サービス・レ

· のグリ なる。 をさせることが有効策と る機器には最大限の仕事

えでも、使わないマシン

給側だけが担う

ドでの分担も視野に入れ サービス利用者サイ S L A この観 のでな

れる。 さらに省エネ対応を供

氏

変換を介さず高圧の直流 と共同で分散電源による で配電することで高効率 源の普及を念頭に、 構成を開発した。分散電 直流多端子配電システム

分散電源による直流多端子配電システム構成

関室を小型化できるなど

プロペラをもつCRPに

イドギャップ半導体の特

CやGaNなどワ

例えば高速制御技術、

(材料開発)、第二フェ

開発は、第一フェーズSiCパワーデバイス

流のエネルギーを二枚の っていたプロペラの回転

動しプロペラを回す。機

船はエンジンで発電し、 船を開発した。電気推進 を採用した内航電気推進

が課題とされていた。

従来の船では無駄にな

と機器の小型化が期待で れば、さらなる燃費向上 化による損失低減が加わ 善にSiCインバーター Pでのエネルギー効率改 運転にて確認した。CR 現していることを海上試

ラトリー研究主幹 四戸 孝氏東芝研究開発センター電子デバイスラボ

きる。

船より燃費が悪化するの め伝達ロスが生じ、従来

パワーデバイスの周辺技術

ユニットリーダ 二見 基生氏 日立製作所日立研究所パワエレシステム 換による損失防止を目指 にこたえ今回は多段の変 し、六きばから六百ば

交流 含むエリアを想定してい 光など直流発電源があり づくりも目指した。 二十がは規模の発電所を 期した高信頼なシステム モデルとしては、太陽 に高効率で直接変換する

装置が必要となる。これ ルでは高圧での直流変換 る。この規模の想定モデ い。る高効率化にも期待した イスの進化によるさらな イッチングしたが、デバした。IGBT直列でス DC/DC変換器を試作

配電を図る。併せて故障

事故時の保護に万全を

電鉄用パワーデバイス・インバーター

報を主に扱う電子工学と

ポイントとなる。

こうした課題へのアプ

炭素社会実現に向けての 低減と変換段数削減が低

しての性格を強めて

スはコンピューターと情

現代のエレクトロニク

開発センターシステム統合化 三菱電機 先端技術総合研究所 エレクトロニクスシステム

新幹線をはじめとする デバイスで 三ゅがのIGBTで三

タ)が浸透している。電 型バイポーラトランジス はIGBT(絶縁ゲート ている。 ンバーターなどで対応し レベルの回路を組んだイ

も高い新幹線では、三・ ば架線電圧が在来線より 対応が要求される。例え 鉄では特に大容量高電圧 SFETとショットキバ機ではSiCパワーMO デバイスとしてのSiC への期待も高い。三菱電 次世代の電鉄用パワー

● S·-Cパワー素子の現状と課題

木本 京都大学工学研究科電子工学専攻教授 恒暢 氏

ン抵抗を最大の特徴と トを備えている。パワー材料として多くのメリッ 動作などパワーデバイス 高速スイッチング、高温 する。高耐圧、高周波・ SiCは低損失(低オ み二〇〇一年にSiCシ とが予想されている。 既存のシリコンパワー 二百ぱあたりを境に、 バイスに取って代わるこ その実用化も着々と進

リアダイオードを試作評

健史氏 オン抵抗・スイッチング えるべく、パッケージ技に要求される長寿命に応 を挙げている。 ロスなど特性面で好成績 実用化に際しては電車 意識が高まる中、電力エる。しかし地球環境への 重要性を増している。 レクトロニクスとしても ネルギーを扱うパワーエ

電気エネルギ

の流れ

では、損失が半減すると

いう試算もなされてい

イス搭載のインバーターい。ちなみにSiCデバ

る。

ワイドギャップ半導体

注目している。 デバイスの開発動向にも 術の進化にも期待した い。またさらなる高耐圧 子の一・二点までの間 費の末端である半導体素 に、多段に渡る電流・電 を概観すると、発電所の 五十万点の世界から消 圧の変換過程が介在す

ョットキバリアダイオー

性のテスト段階に到達し ワーモジュールなどで数 MOSFET、大容量パ ており、高移動度SiC 視野に入り、現在は信頼 十党級の製品も登場して 電流化も進み千二百㎞・ MOSFETも実用化が いる。本命であるSiC 考えたい。海外企業との 導体が、現在なぜ必要な きた。ワイドギャップ半 スは、電車の例のように のか、低損失、高密度動 かなり昔から利用されて パワー

デバイスでは六百から千 現在では大 されている。 々の優れた研究開発がな

> を行うべきであろう。 明確にし、集中的な研究 番強みを発揮できるかを

> > 携を築いていきたい

ウエハー

から素子、シ

ス機器を実現するために 優れるパッケージング技

なパワーエレクトロニク て、高効率でコンパクト 性を最大限に引き出し

めの接合技術、熱対策に ダクタンスで引き出すた 流密度を低抵抗・低イン 電磁波ノイズ対策、大電

装置開発を軸とした材料

・素子との連携開発が強

三フェーズ(応用開発) ズ(素子開発)を経て第

へと進展しており、応用

は、デバイス自身の性能

耐熱性の高い受動部

く求められている。

も大きな役割を果たす。

向上だけでなく周辺技術 品、効率的な冷却技術な

ロニクス革新のために産総研は何をするかエネルギー問題を解決するパワーエレクト -半導体

奥村 元氏 工レクトロニクス研究ラボ長産業技術総合研究所エネルギー

また材料としてのウエ 応用に際してのシス デバイスと回路設

められる。 能向上にとどまらず、実 装や熱解析なども包括し

テム技術など関連諸技術 も欠かせない。この観点 の連携が図れる体制構築

究所では、システムの効 のもと、産業技術総合研 明らかにしていくことに ャップ半導体の有用性を 能実証により、ワイドギ 併せて産業界を軸とす

GaNなどワイドギャッ ローチとして、Si

プ半導体への期待は高

・まとめ

その各段階での損失

からの取り組みが必要と の活用にはさまざまな面

なる。例えばインバー

な研究開発の動きにも期 術プロジェクト」のよう る「グリーンパワエレ技

ーでは素子レベルでの性

研究コーディネーター 産業技術総合研究所 大和田野

-エレクトロニク

競合も激しさを増す中、 ニーズがあり、どこが一 本当に新しい素子を開発 していくにはどこに一番 ために、今後もさまざま な企業、大学と強固な連 が、真に新しいパワ れらの基盤づくりにおい ステムに至る一貫した体

レクトロニクスの革新の て長年努力をしてきた あると思う。産総研はこ ゆる階層の連携が必要で していくことには、あら 制をニーズに応じて構築